

盛合晶微半导体有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛合晶微半导体有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行募集资金净额的实际情况，调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 3 月 3 日出具的《关于同意盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕373 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,546.6162 万股，发行价格为 19.68 元/股，本次募集资金总额为人民币 5,027,574,068.16 元，扣除发行费用人民币 248,973,009.21 元（含增值税），实际募集资金净额为人民币 4,778,601,058.95 元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2026 年 4 月 15 日出具《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0052 号）。募集资金到账后，公司已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《盛合晶微半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	三维多芯片集成封装项目	840,000.00	400,000.00	398,216.75
2	超高密度互联三维多芯片集成封装项目	300,000.00	80,000.00	79,643.35
合 计		1,140,000.00	480,000.00	477,860.11

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于实际募集资金净额低于原计划募投项目拟投入募集资金金额的实际情况，为保证募投项目的顺利实施作出的决策。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金不足部分由公司自筹资金解决，不影响公司募投项目的实施和募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的审议程序

公司于2026年5月29日召开第一届董事会审计委员会第七次会议、第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行募集资金净额的实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

经审议，董事会审计委员会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额系基于实际募集资金净额低于原计划募投项目拟投入募集资金金额的实际情况，为保证募投项目的顺利实施作出的决策，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年5月30日